

SSD

セットトレンド

- ・クラウド化の加速
エンタープライズ用途
HDD→SSD併用化
- ・瞬低対策
SSDのバックアップ必要

電源回路の動向

- ・データ保護需要増加
- ・インタープライズ用途増加

SSDバックアップ用途

<課題>

*耐リフロー性
⇒導電性部品で解決

キャパシタ
要求仕様

大容量

低背

小形化

高耐圧

推奨商品特長

POSCAP

- ・大容量
- ・低背(1.5mm~)
- ・高耐圧(~35V)

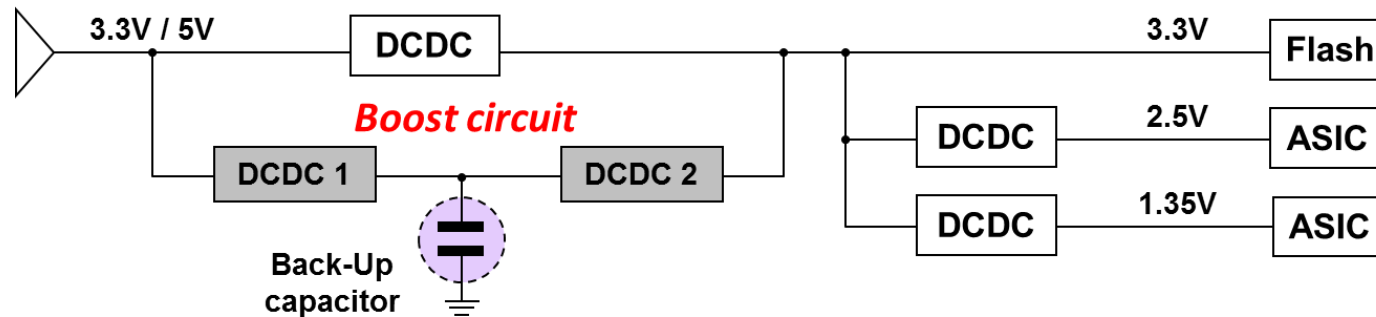


SP-Cap

- ・低背(1.2mm~)



回路事例



<推奨アイテム>

定格	POSCAP	SP-Cap
6.3V	6.3V470uF(D1.5mm)	6.3V220uF(D2mm)
16V	16V100uF(D2mm) 16V150uF(D2mm) 16V150uF(D3mm)	-

定格	POSCAP	SP-Cap
20V	20V100uF(D3mm)	-
25V	25V68uF(D3mm)	-
35V	35V15uF(D2mm)	-